

N800BH-s

Non-Silicone Thermal Conductive Pad

LiPOLY N800BH-s はノンシリコーン樹脂の材料で作りました。低分子シロキサの揮発は少ないので、電子回路接点不良という状況はなりません。N800BH-s は良い熱伝導性があって、熱伝導率は $11.0\text{ W/m}^2\text{K}$ です。熱抵抗も低いて、光学製品や敏感な電子部品の使用には適合です。

■ 製品の特性

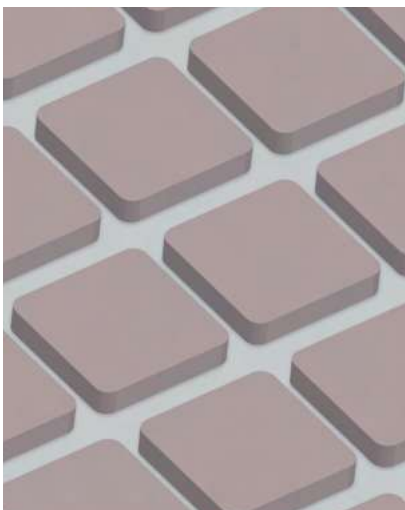
/ 熱伝導率: $11.0\text{ W/m}^2\text{K}$
/ ノンシリコーン材料
/ 接触熱抵抗が小さい
/ 電気絶縁
/ 優れる熱伝導率
/ 光学デバイスに適合

■ 製品アプリケーション

/ ハードディスク
/ 光学デバイス
/ 5Gの基地局(基幹施設/設備)
/ 電気自動車

■ 製品の形

/ シート状
/ フォーミング形



■ TYPICAL PROPERTIES

PROPERTY	N800BH-s	TEST METHOD	UNIT
Color	Pink	Visual	-
Surface tack 2-side/1-side	2	-	-
Thickness	Customized	ASTM D374	mm
Density	3.3	ASTM D792	g/cm^3
Hardness	50	ASTM D2240	Shore OO
Tensile Strength	0.15	ASTM D412	Kg/cm^2
Application temperature	-60~125	-	$^{\circ}\text{C}$
Low molecular Siloxane (D3 to D20 total)	N.D	Gas Chromatography	%
Outgassing CVCN (wt%)	0.0047	By LiPOLY	-
ROHS & REACH	Compliant	-	-
COMPRESSION@1.0mm			
Deflection @10 psi	13	ASTM D5470 modify	%
Deflection @20 psi	34	ASTM D5470 modify	%
Deflection @30 psi	65	ASTM D5470 modify	%
ELECTRICAL			
Dielectric breakdown	8	ASTM D149	KV/mm
Surface resistivity	$>10^{11}$	ASTM D257	Ohm
Volume resistivity	$>10^{10}$	ASTM D257	Ohm-m
THERMAL			
Thermal conductivity	11.0	ASTM D5470	$\text{W/m}^2\text{K}$
Thermal impedance@10 psi	0.210	ASTM D5470	$^{\circ}\text{C-in}^2/\text{W}$
Thermal impedance@20 psi	0.148	ASTM D5470	$^{\circ}\text{C-in}^2/\text{W}$
Thermal impedance@30 psi	0.088	ASTM D5470	$^{\circ}\text{C-in}^2/\text{W}$

The chemical formula indicates that if Cyclic polydimethylsiloxane ($\text{HO}[\text{Si}(\text{CH}_3)_2\text{O}]_n\text{H}$) is non-reaction, it's volatile anytime and everywhere. For example, when the electric products which has been put in a confined space, the volatile of low-molecular-weight siloxanes will makes the electric products uncontacted.

Thermal Resistance vs. Pressure vs. Deflection

